

钧崴电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、大成基金、嘉实基金、信达澳亚基金、 中银基金、天弘基金、望正资产、东方红资管、 民生通惠资管、华夏基金、禾永投资
时间	2026年1月7日
地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人 员姓名	董事长：颜睿志 董事会秘书、财务总监：张照欣
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1. 公司与铂科新材成立的合资公司，具体的协同效应和未来规划是怎样的？</p> <p>答：公司与铂科新材成立合资公司，核心在于实现技术、客户、制造三位一体的战略协同。铂科新材在磁性材料及电感产品方面具备深厚的技术积累和量产能力，尤其在粉材和电感研发上具有独特优势；而公司则拥有成熟的高端制造体系、严格的品质管控流程以及覆盖北美头部客户销售网络（包括AI服务器、消费电子等领域的重要终端客户）。双方合作基于长远战略考量，同属被动元件领域，应用场景高度重叠。此次合作不是简单的资源互换，而是偏长期的技术与客户协同，旨在</p>

	<p>为客户提供整合认证的一整套解决方案。</p> <p>2. 关于对日本 Flat Electronics 的收购，目前业务整合与技术协同有哪些具体进展？</p> <p>答：本次收购的整合进展顺利，目前已完成了主要客户的拜访与沟通，获得了积极反馈，客户对双方技术整合后的产品能力提升表示期待。技术协同是本次收购的战略重点，Flat Electronics 的高精度薄膜电阻技术将与公司现有合金、厚膜电阻技术平台形成互补，提升综合解决方案能力。</p> <p>3. 公司 2025 年通过参股、合资、收购等方式积极拓展产品矩阵，其背后的战略逻辑是什么？</p> <p>答：公司的战略逻辑核心是围绕技术驱动和客户导向展开。优先在与公司核心能力（电阻、熔断器）协同的领域进行拓展，例如收购日本 Flat Electronics 即是为了强化高端薄膜电阻技术。我们与各行业的头部客户保持紧密互动，他们的需求和建议是我们布局新品类（如传感器、电感）的重要依据，目标是提供完整的电流感测解决方案。同时，我们高度重视与合作伙伴在技术、文化和长期发展战略上的契合度，追求深度、紧密的战略协同，而非简单的财务投资。</p> <p>4. 电流传感器是公司重点发展的新方向，目前进展如何？未来的市场目标和定位是什么？</p> <p>答：公司电流传感器业务进展顺利，该品类导入周期相对较长，目前已进入台达、深圳百千成、海德新能源等多家新能源汽车、AI 服务器及工业领域头部客户的项目中。长期来看，公司看好电流传感器近 200 亿人民币的市场空间。我们将重点布局以 TMR 芯片为代表的先进技术路径，公司的目标是成为全</p>
--	--

	<p>球市场上有竞争力的电流传感器解决方案提供商，对标国际领先企业。</p> <p>5. 公司主营业务电流感测精密电阻未来的增长动力和产品迭代方向？</p> <p>答：电流感测精密电阻的增长动力主要来自两方面：一是市占率的提升，2025年公司成功进入OPPO、vivo、华为、荣耀等多家头部手机品牌供应链，份额正处于持续提升阶段。二是产品升级趋势，客户对电阻的薄型化、高精度、高可靠性要求日益严苛。这推动了产品价值量提升，并形成了技术壁垒。公司通过新材料和新工艺的研发，不断满足客户的高要求，产品规格和性能的持续升级将支撑该业务板块保持健康的增长和盈利水平。</p> <p>6. 公司2026年1月面临首发限售股解禁，请简要评估此次限售股解禁的市场影响。</p> <p>答：本次解禁股份占公司总股本比例较低，整体规模有限。结合当前市场流动性较为充裕，以及电子元器件板块景气度持续向好的背景，公司基本面扎实，对长期发展前景有较强信心。公司将持续做好信息披露和投资者沟通工作，维护市场稳定。</p> <p>7. 公司在分红回购方面有何未来规划？</p> <p>答：公司高度重视股东回报，积极响应监管关于提升投资者回报水平的政策导向，计划优化分红机制，让投资者能够更及时地分享公司发展成果。未来公司将根据市场、资金和股价表现，适时考虑通过多种方式回馈投资者，切实提升股东价值，与投资者共享发展红利。</p>
附件清单 (如有)	无

日期

2026 年 1 月 7 日